

Inhaltsverzeichnis

0. Einführung	1
1. Gegenüberstellung Durchsteckmontage – Oberflächenmontage (SMT)	3
2. Bauelemente und -bereitstellung	5
2.1 Klassifizierung der Bauelemente	5
2.2 Bauelementebereitstellung	6
2.2.1 Bereitstellung bedrahteter Bauelemente	6
2.2.2 Bereitstellung oberflächenmontierbarer Bauelemente	7
2.2.2.1 Schüttgut	7
2.2.2.2 Gurtmagazine	7
2.2.2.3 Stangenmagazine	8
2.2.2.4 Stapelmagazine	8
2.2.2.5 Linear- und Flächenmagazine	9
3. Leiterplatte	10
4. Vor- und nachgelagerte Prozesse	11
5. Der Bestückprozeß	12
5.1 Manuelle Bestückung	12
5.2 Halbautomatische Bestückung	13
5.3 Vollautomatische Bestückung	14
5.3.1 Durchsteckmontage	14
5.3.1.1 Automatische Bestückung axialer Bauelemente	14
5.3.1.2 Automatische Bestückung radialer Bauelemente	15
5.3.1.3 Automatische Bestückung von ICs (DIPs)	15
5.3.2 SMD-Bestückung	16
5.3.2.1 Methoden der Bauelementaufnahme und -platzierung	16
5.3.2.2 Sequentiell-Systeme	18
5.3.2.3 Simultan/Sequentiell-Systeme	18
5.3.2.4 Simultan-Systeme	19
6. Planung von Bestückbereichen	20
6.1 Bestücktechnik	20
6.2 Leiterplattengröße und -material, Bauelementespektrum	20
6.3 Produktionsdaten	20
6.4 Flexibilität	21
6.5 Layout-Planung	21
6.6 Auswahl von Bestückautomaten	22
7. Materialfluß	25
8. Katalogteil	27
9. Anhang	222
Adressenverzeichnis	222
Register nach Hersteller	232
Register nach Typ	234
Register nach Bestückrate	236
Verzeichnis häufig verwendeter Abkürzungen	239
Literaturverzeichnis	240